



KOSDAQ | 반도체와반도체장비

이오테크닉스 (039030)

공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요

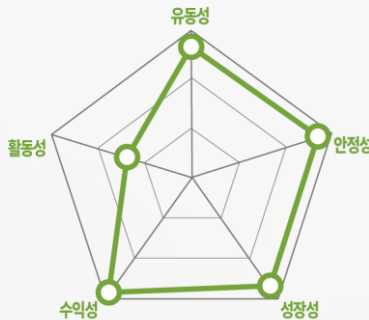
체크포인트

- AI 반도체가 칩렛 구조로 전환되면서 방열판과 EMI 실드 등에서 마킹에 대한 신규 수요가 발생 중. 동사는 북미 GPU 업체의 표준 장비로 채택되며 OSAT 및 조립 업체들의 장비 도입 확대가 이어지고 있음
- 레이저 어닐링 장비는 DRAM에서는 라인당 EUV 장비 대수 증가와 고객사의 DRAM 투자 확대에 따라 어닐링 장비 수요 확대가 기대되며, NAND는 400단 이상 구간에서 채용이 본격화될 것으로 판단
- 2026년 매출액 4,948억원(+29.9% YoY), 영업이익 1,309억원(+62.1% YoY)을 전망. 매출액 확대와 상대적으로 수익성이 높은 반도체 장비 매출 비중 증가로 OPM 26.5%(+5.3%p YoY)를 전망

주가 및 주요이벤트

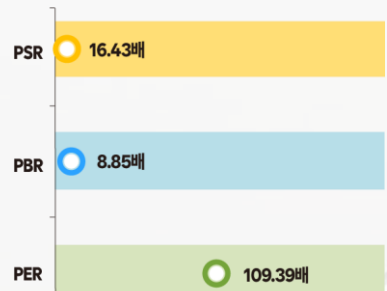


재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 1Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김지은 jekim0216@kirs.or.kr

레이저 기술 기반 장비 업체

이오테크닉스는 1989년에 설립되어 2000년에 코스닥 시장에 상장한 레이저 장비 업체. 주요 장비로 반도체 레이저 마커, 레이저 어닐링, 레이저 커터, PCB 레이저 드릴러, 디스플레이 LLO, 2차 전자 노칭, 웰딩 장비 등이 있음. 2025년 제품 비중은 레이저마커 및 응용기기 74.5%, 기타 25.5%를 기록.

공정, 고객사 확대 진행 중

AI 반도체가 칩렛 구조로 전환되면서 방열판과 EMI 쉴드 등에서 마킹에 대한 신규 수요가 발생 중. 기존 레거시 마커 및 칩스케일 마커는 고객사의 신규 CAPA 투자 확대에 따른 수요 증가가 예상. 레이저 어닐링 장비는 DRAM에서는 라인당 EUV 장비 대수 증가와 고객사의 DRAM 투자 확대에 따라 어닐링 장비 수요 확대가 기대되며, NAND는 400단 이상 구간에서 채용이 본격화될 것으로 판단. 그루빙 장비는 국내 고객사 HBM향 공급을 기반으로 신규 메모리 고객사 확대와 대만 Foundry를 포함한 비메모리 고객사 확대가 동시에 진행 중

신규 수요로 실적 성장 이룰 2026년

2026년 매출액 4,948억원(+29.9% YoY), 영업이익 1,309억원(+62.1% YoY)을 전망. 여전히 고객사의 Fab 공간이 제약되며 동사 레이저 어닐링 장비 기준으로는 공급량이 유사할 것. 레이저 마커는 방열판·EMI 쉴드 마킹 등 신규 장비 수요가 견인. 커팅 장비는 HBM향 Ultra Short Pulse 장비 공급을 중심으로 성장이 지속될 것으로 판단. 메모리 신규 고객 및 비메모리로 확대는 신규 Fab이 열리는 2027년 본격화될 것으로 예상. 매출액 확대와 상대적으로 수익성이 높은 반도체 장비 매출 비중 증가로 OPM 26.5%를 전망

Forecast earnings & Valuation

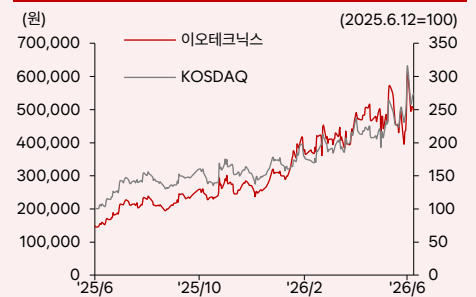
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액(억원) | 4,472 | 3,163 | 3,209 | 3,809 | 4,948 |
| YoY(%) | 14.4 | -29.3 | 1.5 | 18.7 | 29.9 |
| 영업이익(억원) | 928 | 309 | 312 | 808 | 1,309 |
| OP 마진(%) | 20.8 | 9.8 | 9.7 | 21.2 | 26.5 |
| 지배주주순이익(억원) | 765 | 366 | 428 | 572 | 1,117 |
| EPS(원) | 6,212 | 2,973 | 3,478 | 4,644 | 9,071 |
| YoY(%) | 6.5 | -52.1 | 17.0 | 33.5 | 95.3 |
| PER(배) | 10.7 | 51.4 | 40.0 | 58.6 | 55.0 |
| PSR(배) | 1.8 | 6.0 | 5.3 | 8.8 | 12.4 |
| EV/EBITDA(배) | 6.5 | 43.7 | 40.2 | 34.9 | 41.0 |
| PBR(배) | 1.5 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 7.8 |
| ROE(%) | 15.1 | 6.7 | 7.4 | 8.9 | 15.2 |
| 배당수익률(%) | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

| | | |
|---------------|-----------|----------|
| 현재가(06/19) | | 498,500원 |
| 52주 최고가 | | 612,000원 |
| 52주 최저가 | | 152,700원 |
| KOSDAQ(06/19) | | 966.59p |
| 자본금 | | 62억원 |
| 시가총액 | | 61,413억원 |
| 액면가 | | 500원 |
| 발행주식수 | | 12백만주 |
| 평균거래량(60일) | | 14만주 |
| 평균거래대금(60일) | | 664억원 |
| 외국인지분율 | | 25.08% |
| 주요주주 | 성규동 외 10인 | 31.06% |
| | 미래에셋자산운용 | 10.91% |

Price & Relative Performance



Stock Data

| 주가수익률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
|----------|------|-------|-------|
| 절대주가 | 7.3 | 101.0 | 224.5 |
| 상대주가 | 20.4 | 90.3 | 162.7 |

▶참고 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '영업 이익 증가율', 수익성 지표는 '영업이익률', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 이오테크닉스는 반도체 및 디스플레이 제조용 레이저 응용 장비 업체

이오테크닉스는 1989년 설립되어
2000년 코스닥 상장한
레이저 응용 장비 전문기업

이오테크닉스는 반도체, 디스플레이 및 PCB, 제조 공정에 사용되는 레이저 응용 장비 전문기업이다. 주력 제품인 레이저 마커를 시작으로 드릴링, 커팅, 어닐링, 그루빙 등 다양한 레이저 가공장비로 제품군을 확대하며 사업 영역을 확장해 왔다. 특히 핵심 광원인 Fiber, DPSS, DDL 레이저를 자체 설계·생산하는 수직계열화 구조를 구축해 기술 경쟁력과 원가 경쟁력을 확보하고 있다.

1989년 설립된 동사는 1994년 기업부설연구소를 설립하며 레이저 응용기술 개발을 본격화했고, 2000년 코스닥 시장에 상장했다. 이후 미국·싱가포르·대만·중국 등 주요 지역에 현지 법인을 설립하며 글로벌 영업망을 확대했으며, 2009년 영국 Powerlase, 2011년 독일 Innovaent GmbH를 인수해 레이저 광원 및 공정 기술을 내재화했다. 이러한 기술력과 글로벌 사업 기반을 바탕으로 동탑산업훈장, 1억불 수출의 탑, World Class 300 선정, 반도체의 날 대통령 표창 등을 수상하며 국내 대표 레이저 장비업체로 자리매김했다. 주요 고객사는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, LG디스플레이를 비롯해 BOE, ASE 등 글로벌 반도체·디스플레이 업체들이다.

최근에는 반도체 설비투자 확대와 HBM 고적층화가 진행되면서 동사 장비의 적용 범위가 확대되고 있다. 동사는 삼성전자에 DRAM용 레이저 어닐링 장비를 공급하고 있는데, 향후 어닐링 장비 공급처가 확대될 경우 추가적인 성장 동력으로 작용할 것으로 기대된다. HBM 적층 단수 증가와 웨이퍼 박막화 역시 우호적이다. 적층 수가 증가할수록 웨이퍼 절단 공정의 난이도가 높아지면서 그루빙 공정의 중요성이 커지고 있으며, 동사는 초단펄스(USP, Ultra Short Pulse) 레이저 기반 그루빙 장비에서 경쟁력을 확보하고 있다. 이에 따라 삼성전자 등 메모리 업체와 OSAT향 공급이 확대되는 추세다. 이와 함께 전방 Fab 투자 확대에 따른 레이저 마커 수요 증가와 FC-BGA 등 고부가 기판 투자 재개에 따른 PCB 장비 수요 회복이 더해지면서 중장기 성장세가 이어질 것으로 전망된다.

이오테크닉스 연혁

| 1989~2004 창업 및 시장 진출 | 2005~2011 성장 및 핵심 기반기술 추구 | 2012~ 글로벌 리더십 경쟁 |
|---|--|--|
| <p>1989 이오테크닉스 설립</p> <p>1993 법인전환</p> <p>1994 기업부설연구소 설립</p> <p>1996 국산 신기술 인정(K마크) 획득 (과학기술서)</p> <p>유망 신진 기술 기업 지정 (중소기업청)</p> <p>1997 정밀 기술 경진 대회 중소기업청장상 수상</p> <p>1998 벤처기업 등록</p> <p>필라핀 지사 설립</p> <p>ISO9001/FDA인증</p> <p>EMMark 획득 (통상산업부)</p> <p>우수품질 인증제품 국무 총리상 수상</p> <p>경기도 유망중소기업 선정</p> <p>1999 EM Tech 설립</p> <p>싱가포르 현지법인 설립</p> <p>미국 현지 법인 설립</p> <p>2000 KOSDAQ 상장</p> <p>대만 법인/태국, 인도네시아 지사 설립</p> <p>CE/S2 인증 획득</p> <p>천민불 수출탑 수상</p> <p>대통령 표창</p> <p>세계 일류상품 생산기업 선정(산업자원부)</p> <p>Cypress Semiconductor 우수 공급자상</p> <p>2001 한국 World-Class 제품상 수상 (산업통상자원부)</p> <p>세계 일류상품 지정 (산업통상자원부)</p> <p>2002 SEM 인증 획득(CSM)</p> <p>CE 인증 획득</p> <p>2003 중국진진 현지법인 설립</p> <p>2004 신관건물 증축 완공</p> <p>2천민불 수출탑 수상</p> <p>장영실상 수상(CSM2000, CSM3000)</p> | <p>2005 3천민불 수출탑 수상</p> <p>삼성전자 협력회사협의회 회원사 선정</p> <p>삼성전기 협부회 회원사 선정</p> <p>삼성전기 특별상 수상</p> <p>2006 Laser Via Tech 설립</p> <p>한국반도체연구조합 회원사 선정</p> <p>2007 동탑산업 훈장 수상 (성규동 대표이사)</p> <p>Forbes 아시아태평양지역 Best 200 중소기업 선정</p> <p>2008 중국 소주 법인 설립</p> <p>5천민불 수출탑 수상</p> <p>2009 영국 Powerlase 인수</p> <p>Forbes 아시아태평양지역 Best 200대 중소기업 선정</p> <p>2010 7천민불 수출탑 수상</p> <p>NET 신기술인증 (지식경제부)</p> <p>기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 지정 (중소기업청)</p> <p>300억 자금 투자 유치 칼리일 그로스코리아(Carlyle Growth Korea, LLC.)</p> <p>수출강소기업 Plus 500 선정</p> <p>BK 수출탑 은상 수상</p> <p>삼성전기와 Stop CO2 멘토링 협약 체결</p> <p>2011 UTAC Group 우수 공급자 수상</p> <p>중국 소주공장 준공</p> <p>독일 Innovavent GmbH 인수</p> <p>벤처매출 천억기업 수상</p> <p>Fobes 아시아태평양지역 Bset 200대 중소기업 선정</p> <p>Ernst & Young Entrepreneur</p> <p>Amkrar Group 최우수장비상 수상</p> <p>UTAC Group 우수 공급자 수상</p> <p>OSE Group 우수 공급자 수상</p> | <p>2012 본사사옥 이전</p> <p>관양동 R&D 센터 준공</p> <p>특허경영우수상 수상(특허청장 표창)</p> <p>KRX(히트챔피언 선정</p> <p>KOTRA 글로벌 브랜드 2012 금상 수상</p> <p>삼성전자 혁신기술기업 협의회 회원사 선정</p> <p>StatsChipPac Group 우수 공급자 수상</p> <p>2013 EO Club 설립</p> <p>경기도 성장남세자 인증</p> <p>IBK 무역탑 금탑</p> <p>Fobes 아시아태평양지역 Best 200대 중소기업 선정</p> <p>삼성전자 2013 올해의 강소기업</p> <p>삼성전자 혁신우수 협력사 동상</p> <p>LG노벨 Winners Partner상</p> <p>ASE반도체 우수공급자상</p> <p>한국광학회 기술상</p> <p>2014 베트남 지사 설립</p> <p>1억불 수출의 탑 수상</p> <p>산업혁신 3.0 표창대 수상</p> <p>코스닥 히트챔피언 선정(6년연속)</p> <p>SDC 혁신우수협력사 금상 삼성전자 혁신우수협력사</p> <p>지랑스런 삼성인 특별상</p> <p>SPL반도체 우수공급자상</p> <p>OSE Group 우수 공급자 수상</p> <p>삼성전기 동반성장대상</p> <p>2015 IBK 집월드 선정 알자리리 창출 우수 기업 선정</p> <p>한국생산기술연구원파트너기업 선정</p> <p>CMM 레벨 3 인증 획득</p> <p>2015 코스닥 라이징 스타 선정</p> <p>IBK 기업은행 제12회 기업인 명예의 전당 한장자 선정</p> <p>World class 300 글로벌 전문기업 선정</p> <p>Fobes 아시아태평양지역 Best 200대 중소기업 선정(5회연속)</p> <p>SPL Group 우수 공급자 수상</p> <p>LG Innotek 협력사 우수상 수상</p> <p>2017 한국형 히트챔피언 우수기업상</p> <p>2017년 STEMCO 감사패</p> <p>성실 납세이행 금탑산업훈장</p> <p>2016 Phoenix Pioneer Technology Best Partner 수상</p> <p>2018 ASE Group, Outstanding Supplier 선정</p> <p>서울대학교 감사패</p> <p>OSE 우수공급자 선정</p> <p>2018 코스닥 라이징 스타 선정</p> <p>2019 2019 코스닥 라이징 스타 선정</p> <p>동반성장위원회 감사패</p> <p>SDC 혁신우수협력사 대상 수상</p> <p>고에-지연구위원회 감사패</p> <p>2020 2020 코스닥 라이징 스타 선정</p> <p>대통령 표창 (반도체의 날)</p> <p>SEC 혁신우수협력사 금상 수상</p> <p>SDC 공로상</p> <p>한국반도체산업협회 감사패</p> <p>삼성전자 혁신우수협력사 금상 수상</p> <p>2021 2021 코스닥 라이징 스타 선정</p> <p>2022 2022 코스닥 라이징 스타 선정</p> <p>KOPHA 올해의 경영인</p> <p>삼성전자 감사패</p> <p>인양시 시민대상</p> <p>글로벌세그먼트 지수 편입</p> <p>2023 2023 코스닥 라이징 스타 선정</p> |

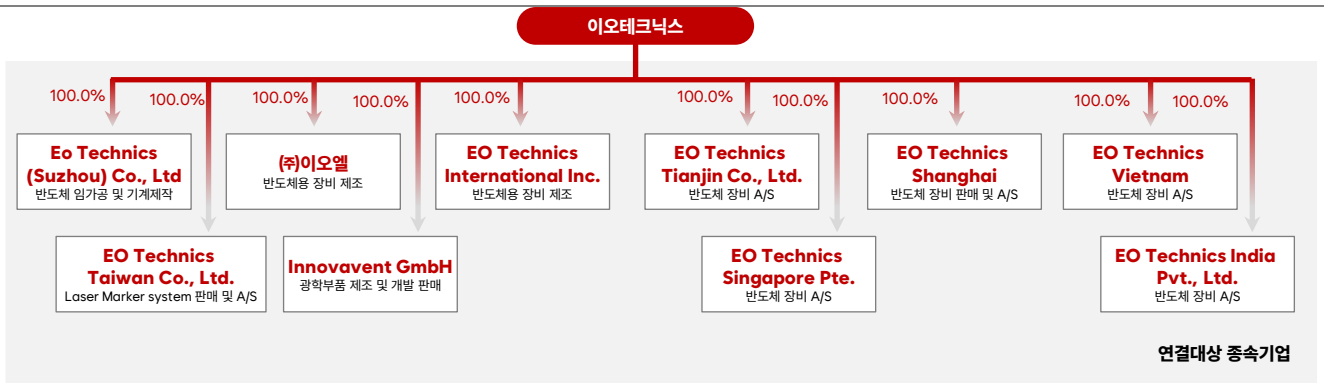
자료: 이오테크닉스, 한국R협의회 기업리서치센터

2 종속회사 현황

**2025년 말 기준 총 10개의
연결대상 종속회사 보유**

이오테크닉스는 2025년 말 기준 총 10개의 비상장 종속회사를 연결대상으로 보유하고 있다. 이 중 Eo Technics (Suzhou) Co., Ltd.는 중국 내 생산 거점으로, 2025년 말 기준 지분을 100.0%, 자산총액 471억 원 규모이며, EO Technics Taiwan Co., Ltd.는 대만 지역에서 레이저 마커 시스템의 판매 및 A/S(애프터서비스) 사업을 수행하고 있으며, 지분을 100.0%, 자산총액은 215억 원이다. 또한, Innovaent GmbH는 독일 소재의 광학 부품 제조 및 개발 전문 기업으로, 지분을 100.0%, 자산총액 118억 원이며, 기술 기반의 유럽 시장 대응을 위한 전략적 거점 역할을 수행하고 있다. 이 외 나머지 7개의 종속회사 역시 대부분 반도체 장비의 해외 판매 및 유지보수(A/S) 사업을 중심으로 운영되고 있으며, 이오테크닉스의 글로벌 고객 대응력 및 현지 기술자원을 강화 목적으로 운영되고 있다

이오테크닉스 지분도



주: 2025년말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 주요 사업 및 매출 구성

**2025년 제품 비중은
레이저마커 및 응용기기 74.5%,
기타 25.5%**

동사는 레이저를 이용한 반도체, PCB, 디스플레이, 스마트폰 산업의 주요 생산 장비를 제조한다. 동사의 주요 사업은 반도체 레이저 마커, 레이저 어닐링, 레이저 커터, PCB 레이저 드릴러, 디스플레이 LLO, 2차전지 노칭, 웰딩 장비 등이 있다. 2025년 제품 비중은 레이저마커 및 응용기기 74.5%, 기타 25.5%의 구성을 보였다. 수출 비중은 52%를 기록하였다.

<반도체>

1) 레이저 마커

동사의 핵심 장비로 가장 큰 매출 비중을 차지하는 장비군이다. 반도체 레이저 마커(Marker)는 국내 95%, 해외 60%의 시장 점유율을 차지하는 것으로 추정된다. 레이저 마킹은 고출력 레이저 빔을 타겟 표면에 집속시켜 열 변형, 제거(Ablation), 발포(Foaming) 등을 유도해 식별 정보를 각인한다. 기계적 접촉이 없는 비접촉식이기 때문에 초정밀 반도체 소자의 물리적 손상 위험을 원천 차단하는 것이 강점이다. 레거시 마커와 웨이퍼 마커로 크게 구분할 수 있다.

레거시 마커: 패키징 완료 후 표면에 제조사, 품목명, 로트 번호 등을 기입하는 용도

웨이퍼 마커: 웨이퍼 및 개별 다이(Die) 단위에 고유 ID를 부여하여 전 공정 단계에서의 로트 추적성(Traceability) 확보, 불량 분석, 고객사별 제품 식별을 가능케 하는 고부가 장비

2) 레이저 어닐링

이온 주입(Ion Implantation) 공정 이후, 훼손된 웨이퍼의 결정 구조 복원 및 도펀트(Dopant) 활성화를 위해 레이저로 국소 부위를 초고속 가열, 냉각하는 열처리 장비이다. 기존 Furnace나 RTP(급속열처리) 방식은 웨이퍼 전면에 열을 가해 박막 변형이나 소자 불량률 유발할 리스크가 컸다. 반면 동사의 레이저 어닐링은 결합 영역만 선택적으로 조사하므로 열 전달 시간을 최소화하고, 불순물의 과도한 확산을 억제해 초미세 박막 형성을 가능하게 함으로써 수율 개선의 핵심 역할을 수행한다. 동사 장비는 1z nm DRAM 공정 진입을 기점으로 빠르게 성장했다. 주요 고객사는 삼성전자, 국내 주요 경쟁사는 다이이티가 있다.

3) 레이저 커터

반도체 후공정 내 싱글레이션(Singulation, 웨이퍼를 개별 칩 단위로 분리) 단계에서 활용되는 장비로, 세부적으로는 스텔스 다이싱(Stealth Dicing), 그루빙(Grooving), 풀 커팅(Full Cutting) 기술을 포함한다. 수 마이크로미터(μm) 수준의 정밀 제어가 가능해 다이 간격(Scribe Lane)을 최소화하는 미세 공정에 필수적이며, 전통적인 휠 블레이드(Mechanical Blade) 방식 대비 다이 칩핑(Chipping) 등 물리적 데미지를 최소화한다. 글로벌 시장 내 주요 경쟁 상대는 일본의 Disco이다.

<PCB>

레이저 드릴

고성능 PCB에 비아 홀(Via Hole), 관통 홀(Through Hole), 블라인드 비아(Blind Via) 등을 초정밀 타공하는 장비이다. 기판 특성 및 공정 요구도에 따라 CO₂ 레이저(파장 9.3~10.6 μm) 또는 UV 레이저(파장 355nm) 소스를 선택적으로 채택한다. 시장 내 주요 경쟁사로는 일본의 Mitsubishi, Hitachi, 그리고 미국의 ESI가 있다.

<디스플레이>

LLO

Flexible OLED 패널 제조 공정의 필수 장비이다. 폴리이미드(PI) 필름 하단의 릴리스 레이어(Release Layer)에 레이저 에너지를 선택적으로 조사, 분해함으로써, 기판 역할을 하던 캐리어 글라스(Carrier Glass)로부터 플렉시블 패널을 물리적 손상 없이 박리(Lift-Off)시킨다. 주요 고객사는 LG디스플레이며 시장 내 주요 경쟁사로는 AP시스템이 있다.

<2차전지>

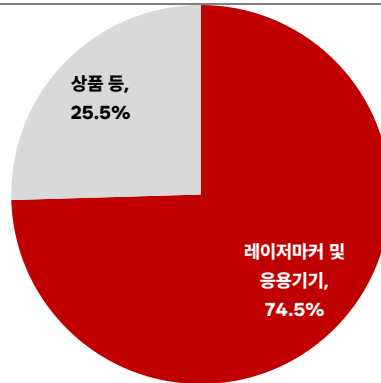
1) 노칭

배터리 셀 제조 중 전극 공정에서 양극 및 음극 극판을 설계된 형상대로 고속 절단하여, 배터리 탭(Tab)이나 특정 기하학적 패턴을 성형하는 장비이다.

2) 웰딩

조립 공정 단계에서 활물질이 도포된 전극판의 탭(양극: 알루미늄, 음극: 구리)을 배터리 외부 단자 또는 캔/파우치 케이스와 전기적으로 연결하기 위해 정밀 접합(용접)하는 장비이다.

이오테크닉스 매출 비중



주: 2025년 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 주요 제품



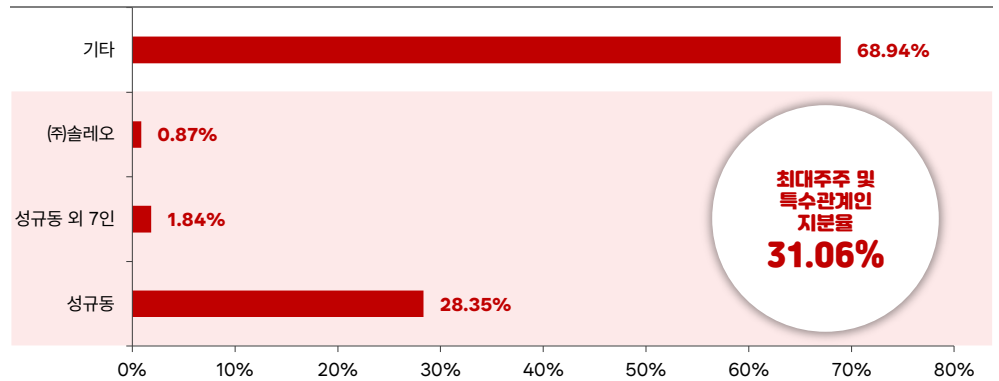
자료: 이오테크닉스, 한국IR협회의 기업리서치센터

주주 구성

최대주주는 대표이사 성규동으로 지분을 28.35% 보유, 최대주주 특수관계인 지분 합계는 31.06%

이오테크닉스의 최대주주는 성규동 대표이사로서, 개인 지분 28.35%를 보유하고 있으며, 성 대표를 포함한 최대주주 및 특수관계인의 지분 합계는 31.06%이다. 성 대표는 서울대학교 전기공학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사 학위를 취득했으며, 금성중앙연구소, 대우중공업 기술연구소, 코리아레이저 등을 거쳐 1989년 이오테크닉스를 설립했다. 창업 이후 세계 최초로 펜 타입 레이저 마킹 장비를 개발하였고, 현재는 한국반도체산업협회 이사로도 활동하고 있다

이오테크닉스 주주 현황



주: 1Q26말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

산업 현황

1 글로벌 반도체 장비 시장 전망

글로벌 300mm 팹 장비 투자액은 2026년 18%, 2027년 14% 증가 전망

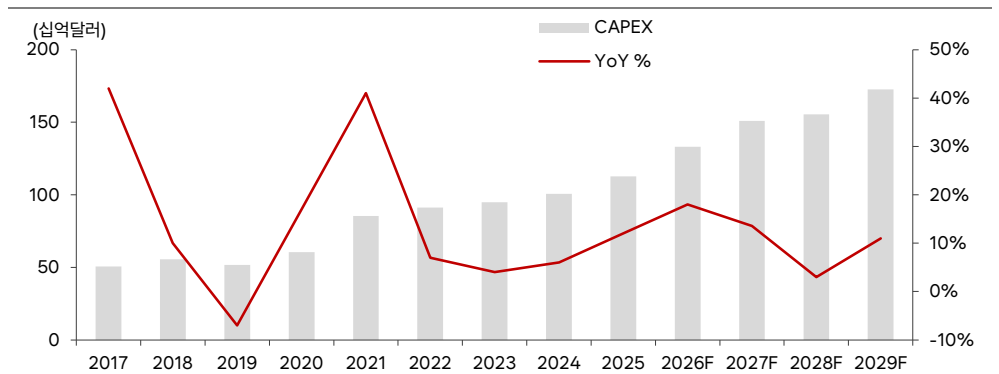
전 세계 300mm 팹 장비 투자액은 2026년에는 18% 증가한 1,330억 달러, 2027년에는 14% 증가한 1,510억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이는 데이터 센터 및 엣지 디바이스용 AI 칩 수요 급증과 주요 지역에서 현지화된 산업 생태계 및 공급망 재편을 통해 반도체 자급자족을 강화하려는 움직임에 기인한다. 2028년에는 3% 증가한 1,550억 달러, 2029년에는 11% 증가한 1,720억 달러에 이를 것으로 전망된다.

로직 및 마이크로컴포넌트 부문은 2027년부터 2029년까지 총 2,280억 달러의 투자를 통해 장비 확장을 주도할 것으로 예상된다. 주로 2nm 이하의 최첨단 설비 투자로 파운드리 부문이 강력한 수요를 견인할 것이다. 첨단 노드 기술은 다양한 AI 애플리케이션의 까다로운 칩 설계 요구 사항을 충족하기 위해 칩 성능과 전력 효율을 향상시키는 데 필수적이다. 더욱 발전된 노드 기술은 2027년부터 2029년 사이에 양산 단계에 진입할 것으로 예상된다. AI 성능 향상은 다양한 엣지 AI 기기의 폭발적인 성장을 견인하고, 첨단 노드 기술 외에도 모든 노드 및 다양한 전자 기기에 대한 수요는 완만하게 증가할 것으로 예상되어 기존 노드 기술에 대한 투자도 이어질 것으로 보인다.

메모리 부문은 2027년부터 2029년까지 총 1,750억 달러의 장비 지출이 예상된다. DRAM 장비 지출은 2027년부터 2029년까지 누적 1,110억 달러에 이를 것으로 예상되며, 3D NAND 장비 지출은 같은 기간 동안 620억 달러에 이를 것으로 전망된다.

지역별로 중국에서는 지속적인 국내 생산 능력 확장과 반도체 제조 역량 강화를 위한 국가적 정책에 힘입어 투자가 꾸준히 이어질 것으로 예상된다. 대만 지역에서는 2nm 이하 기술을 포함한 최첨단 파운드리 설비 확충이 투자 성장을 주도할 것으로 전망된다. 한국은 AI 관련 수요 증가로 CAPA 확대 및 테크 마이그레이션이 메모리 부문에 집중될 전망이다. 미국은 첨단 공정 확장과 국내 제조 생태계 강화로 투자가 증가할 것으로 예상된다.

글로벌 300mm Fab 장비 투자액 전망



자료: SEMI, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 반도체 시장 전망

**2026년 글로벌 반도체 시장은
2025년 대비 +98.7% YoY
증가한 1.57조 달러 전망**

2026년 글로벌 반도체 시장은 2025년 7,903억 달러에서 +98.7% YoY 증가한 1.57조 달러가 전망된다. 북미 CSP의 AI 설비투자가 지속됨에 따라 AI 프로세서, 관련 IC 및 메모리 수요 강세가 유지될 전망이다. 2026년 글로벌 메모리 시장은 2025년 2,247억 달러 대비 +295.8% 성장한 8,893억 달러가 예상된다.

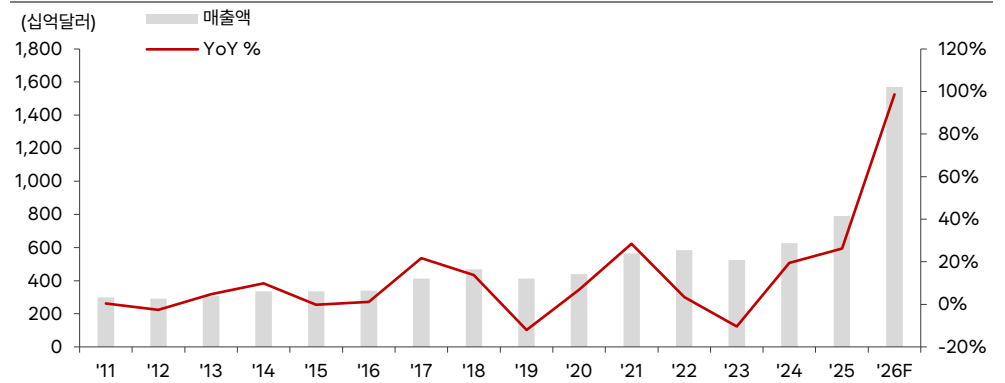
AI 애플리케이션이 LLM 학습에서 AI 추론으로 발전함에 따라 CSP 데이터 센터는 AI 전용 서버에서 범용 서버로 구축 우선순위를 전환하고 이러한 변화로 메모리 조달 수요는 HBM, LPDDR5X 및 고용량 RDIMM을 넘어 다양한 용량의 RDIMM 제품까지 확대되고 있다. DRAM 공급업체의 재고 수준은 극히 낮은 수준을 유지하고 있으며 AI 서버용 고용량 RDIMM의 공급 확대가 우선시되고 있다. 이로 인해 PC OEM 및 스마트폰 제조사의 제품 공급이 제한되고 일반 DRAM의 bit 출하량 증가는 당분간 제한적일 것으로 보인다. 가격 측면에서는 CSP들이 가격 인상을 수용하는 데 더 적극적이다. 이에 따라 다른 고객들도 공급 확보를 위해 가격 인상을 수용하고 있다.

DRAM의 수급 불균형 심화로 2025년 하반기 이후 레거시 DRAM 가격의 급격한 상승이 일어났다. 향후 공급업체들은 HBM 가격 추이에 따라 HBM과 레거시 DRAM 간의 생산 allocation을 조정할 것으로 예상된다. 2026년 HBM 수요 증가는 주로 AI ASIC 용량 업그레이드로 인해 발생할 것으로 예상되며 칩당 HBM 용량이 96GB/192GB에서 216GB/288GB로 크게 증가할 전망이다. 2027년에는 NVIDIA의 Rubin Ultra 플랫폼이 GPU당 HBM 용량을 384GB까지 더욱 늘릴 것으로 예상된다. 상위 3개 공급업체의 HBM 웨이퍼 투입량이 2025년, 2026년, 2027년 말까지 전체 DRAM 웨이퍼 투입량의 약 18%, 22%, 30%를 각각 차지할 것으로 보이며 같은 기간 동안 HBM 비트 공급량은 전체 DRAM 비트 공급량의 각각 약 8%, 9%, 13%를 차지할 것으로 예상된다. 따라서 2027년에도 HBM 세대가 계속 발전하면서 다이 크기가 커지고 수요가 동시에 증가함에 따라 기존 DRAM 생산 능력에 대한 구축 효과는 더욱 심화될 것으로 예상된다. 공급업체에게 HBM 가격 인상을 위한 강력한 명분을 제공하고 내년 HBM 가격 협상에서 가격 결정력을 강화할 것으로 판단된다.

Nvidia의 Vera Rubin에 적용되는 SOCAMM 메모리 용량 축소도 수요 측면의 조정이 아닌 공급 중심의 타협이다. Nvidia는 시장 점유율 확대를 위해 모듈당 메모리 용량을 줄이는 한편 전체 모듈 출하량을 증가시키는 전략을 선택하였다. SOCAMM에 적용되는 LPDDR5X의 공급 부족이 단기적으로 해결되지 못하기 때문이다. Nvidia는 예상 LPDDR 수요량의 약 60%만 수급이 가능한 상황에서 Vera CPU 생산량을 확대하고 장기적인 공급 부족 위험을 완화하기 위해 메모리 탑재량을 하향 조절했다고 판단된다. 따라서 DRAM 수요 하락 신호로 볼 수 없다.

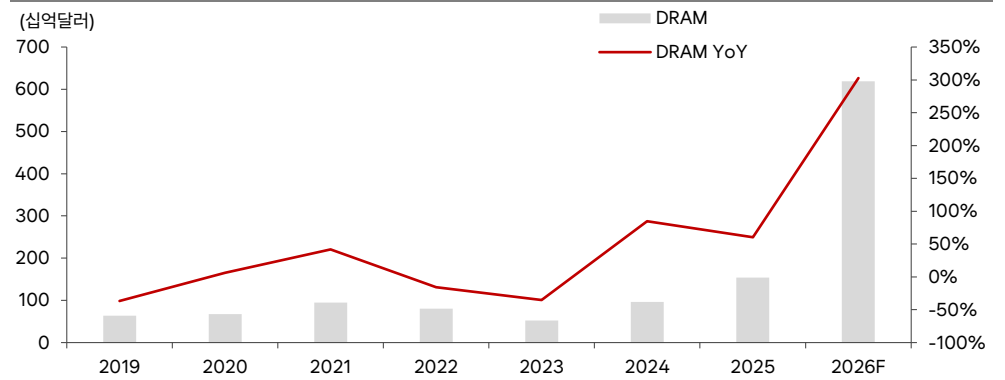
NAND 역시 메모리 비용 상승과 최종 제품 가격 인상으로 스마트폰 및 PC 수요는 위축되었지만, 서버 주문이 호조를 보이면서 이러한 공백이 채워질 전망이다. CSP들은 고속 데이터 전송 및 AI 서버 인프라 구축에 필요한 대규모 데이터 저장 용량에 대한 수요 증가로 인해 기업용 SSD 수요가 크게 증가하고 있다. 기존 HDD의 지속적인 공급 부족으로 인해 스토리지 관련 주문이 상당 부분 QLC 기업용 SSD로 전환되었다. 주요 공급업체의 재고 수준은 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 생산량은 주문 증가율을 크게 따라가지 못하고 있다. 이러한 급증하는 수요와 제한된 공급 속에서 NAND 플래시 공급업체들의 ASP는 상승 기조를 이어갈 것으로 전망된다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이



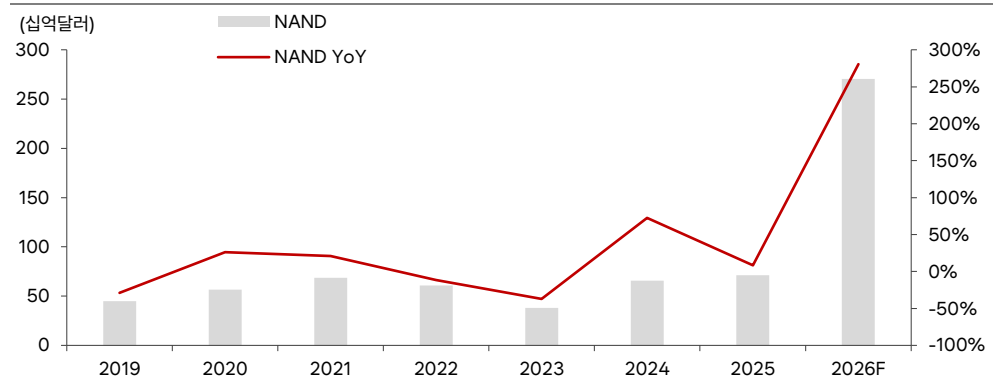
자료: WSTS, Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 DRAM 시장 규모 추이



자료: Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 NAND 시장 규모 추이



자료: Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터



투자포인트

1 레이저 마커 적용 시장 확대

AI 반도체가 칩렛 구조로 전환되며 레이저 마커 신규 수요 발생 중

동사 레이저 마커의 적용 시장 확대에 따른 수요가 지속될 것으로 보인다. 기존 마킹 시장은 웨이퍼나 패키지 표면에 제조사 로고와 시리얼 번호를 새기는 것이 주요 영역이었으나, 최근 AI 반도체가 칩렛 구조로 전환되면서 방열판과 EMI 쉴드 등에서 마킹에 대한 신규 수요가 발생하고 있다. 이는 기존 시장의 성장을 넘어 신규 장비가 추가되는 구조적 변화로 판단된다.

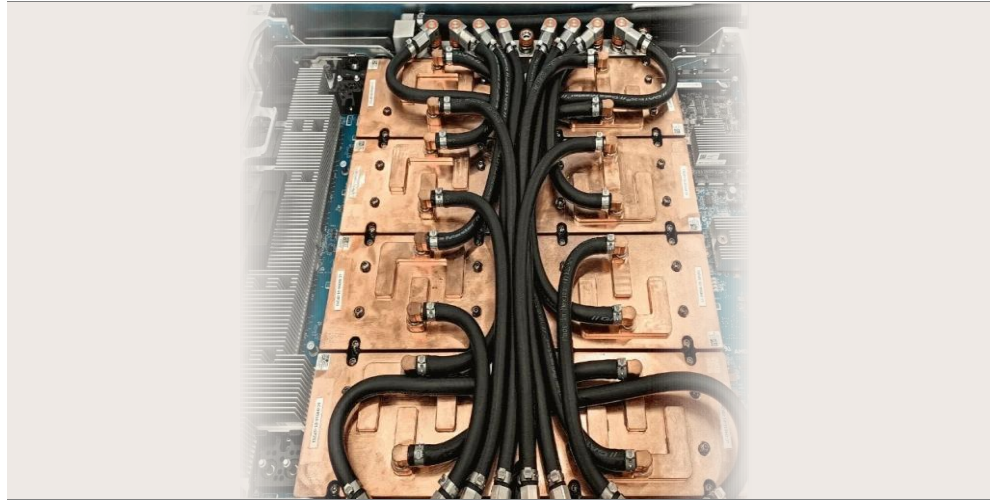
방열판 마킹 수요는 AI 가속기의 발열 밀도가 급격히 높아지면서 수냉식 쿨링 시스템 적용으로 발생하고 있다. 수냉식 쿨링 시스템에 사용되는 워터블록 베이스나 IHS와 같은 금속 부품은 종전에는 별도의 마킹이 필요하지 않았으나, 고가의 AI 서버에 탑재되는 핵심 부품으로 자리매김함에 따라 이력 추적 및 품질 관리를 위한 개별 마킹이 요구되기 시작하였다. EMI 쉴드 역시 유사한 흐름을 보이고 있다. 칩렛 간 고속 인터커넥트가 증가하면서 차폐 처리 적용이 확대되고 있으며, 이 차폐 공정이 완료된 이후 단계에서 식별 정보를 새기는 마킹 공정이 신규로 추가된다.

동사는 북미 GPU 업체의 표준 장비로 채택되며 OSAT 및 조립 업체들의 장비 도입 확대가 이어지고 있는 것으로 파악된다. 통상적으로 표준 장비는 해당 생태계에 속한 협력사들의 수요가 안정적으로 유입될 수 있다는 점에서 우호적이다. 또한 이러한 흐름이 북미 GPU 업체뿐만 아니라 타 업체의 칩셋 설계로도 점진적으로 확산될 가능성이 있다는 점에서 향후 고객 다변화도 함께 기대된다.

기존 레거시 마커 및 칩스케일 마커는 고객사의 신규 CAPA 투자 확대에 따른 수요 증가 예상

기존 레거시 마커 및 칩스케일 마커는 고객사의 신규 CAPA 투자 확대에 따른 수요 증가가 예상된다. 현재는 NAND 투자가 부진한 가운데 HBM과 비메모리 선단 공정 위주로 투자가 집중되고 있으나, 향후 Fab 투자가 점진적으로 재개될 것으로 예상되는 만큼 기존 마킹 장비 수요 역시 함께 확대될 것으로 기대된다. 마킹 장비는 종류가 70개에 이를 정도로 세분화되어 있으며 Fab 투자 사이클에 직접 연동되는 특성을 보유하고 있다는 점에서, 방열판 등 신규 아이템의 성장과 기존 제품의 CAPEX 연동 성장이 동시에 이루어질 것으로 판단된다.

수냉식 서버



자료: Fibermail, 한국IR협의회 기업리서치센터

어닐링 고객사 및 어플리케이션 확대 기대

**레이저 어닐링(Annealing)
장비의 적용 공정 확대 및
신규 고객사 확보 기대**

동사 레이저 어닐링(Annealing) 장비의 적용 공정 확대 및 신규 고객사 확보가 기대된다. 레이저 어닐링은 고출력 레이저 빔을 반도체 웨이퍼 표면에 조사하여 극히 짧은 시간 동안 국소적으로 가열, 냉각함으로써 결정 결함을 치유하고 도펀트를 활성화시키는 열처리 기술이다. 기존의 퍼니스(Furnace) 어닐링이나 급속열처리(RTA)가 웨이퍼 전체를 수백 ~1,000°C 이상으로 수십 초에서 수 분간 가열하는 방식인 것과 달리 레이저 어닐링은 수 나노초(ns)에서 수 밀리초(ms) 수준의 극초단 시간 안에 웨이퍼 표면 수십~수백 nm 깊이만을 선택적으로 가열한다. 이 과정에서 웨이퍼는 상온을 유지하기 때문에 열이 하위 레이어로 확산되지 않는다. 기존의 방식은 웨이퍼 전체에 열을 가하는 방식으로 박막 구조에서는 열에 의한 변형이나 불량 발생 위험이 높다는 단점이 있으나 레이저 어닐링은 국소 영역만을 빠르게 가열함으로써 열 확산을 최소화할 수 있어 미세화가 진행 중인 선단 공정에서 필수적인 기술이다.

**반도체 공정 내 레이저 어닐링은
도펀트 활성화 및 재확산 억제,
Void 제거, 결정화에 사용**

레이저 어닐링이 반도체 공정에서 쓰이는 목적은 크게 세 가지다. 첫째, 이온주입 후 손상된 실리콘 격자 결함을 치유하고 도펀트를 전기적으로 활성화하면서도 재확산을 억제하는 것이다. 이온주입은 붕소(B), 비소(As), 인(P) 등을 실리콘에 강제로 주입하는 과정으로, 높은 충돌 에너지로 인해 실리콘 결정 내 공유결합이 깨지며 결함이 발생한다. 기존 RTA 방식으로 고온 열처리를 할 경우 결함은 치유되나 도펀트가 사방으로 확산되어 Ultra-Shallow Junction 형성이 불가능해지는 반면, 레이저 어닐링은 수 나노초 안에 표면만 가열하여 도펀트가 확산할 물리적 시간 자체가 존재하지 않는다는 장점이 있다. 둘째는 트랜치 내부에 금속을 충전할 때 발생하는 Void 제거다. 텅스텐(W) 등 금속을 CVD로 채울 때 중형비가 높아질수록 완전한 갭필이 어려워져 내부에 Void가 발생하는데, 레이저를 순간 조사하면 금속 표면이 국소적으로 가열되며 재유동(Reflow)이 일어나 Void가 채워지는 효과가 있다. 셋째는 커패시터 유전체나 채널 재료의 결정화다. ZrO₂, HfO₂ 등 고유전율(High-k) 재료는 결정상에서 유전상수가 현저히 높아지는데, 전체 웨이퍼를 고온 처리하면 하부 소자가 손상되기 때문에 레이저로 해당 레이어만 국소 결정화하는 방식이 적용된다.

레이저 어닐링은 DRAM 제조 공정에 필수적

DRAM에서 레이저 어닐링이 중요한 이유는 셀 구조 특성상 위의 세 가지 과제가 한 칩 안에 동시에 존재하기 때문이다. 매립 워드라인(Buried Word Line, bWL)은 레이저 어닐링 장비가 1z DRAM에 처음 투입된 공정이다. bWL은 실리콘 기판 안쪽 트랜치에 금속을 채워 만드는데, 이 과정에서 Void가 생기면 워드라인 저항이 불균일해지고 셀마다 전기적 특성이 달라져 수율이 떨어진다. 특히 bWL은 실리콘 기판 아래 매립되어 있어, 레이저가 Si 표면을 통과해 그 아래 금속층만 선택적으로 가열해야 한다. 이 정밀도가 동사 기술력의 핵심 요소다. 소스/드레인(S/D) 도펀트 활성화는 DRAM의 핵심 품질 지표인 셀 Retention(데이터 유지 시간)과 직결된다. DRAM 셀 트랜지스터는 채널이 수 nm 수준으로 매우 얇아서, 이온주입한 도펀트(붕소, 비소 등)가 채널 쪽으로 조금만 퍼져도 누설전류가 늘어나고 데이터가 금방 사라진다. 레이저 어닐링은 가열 시간을 극도로 짧게 줄여 이 확산을 막아준다. 커패시터 유전체 결정화의 경우 DRAM 커패시터는 좁고 깊은 기둥(실린더) 형태인데, 이 기둥의 종횡비가 50대 1을 넘어설 정도로 가늘고 길어, 기존처럼 웨이퍼 전체를 가열하는 방식으로는 기둥 내부까지 고르게 열을 전달할 수 없다. 게다가 이 공정 단계에 이르면 앞선 두 공정에서 이미 열을 상당히 써버린 상태라, 추가 고온 처리 여지가 없어 레이저 어닐링 적용이 필수적인 것으로 판단된다.

NAND에서의 레이저 어닐링 적용도 적층 단수 고도화에 따라 필요성이 높아지는 추세

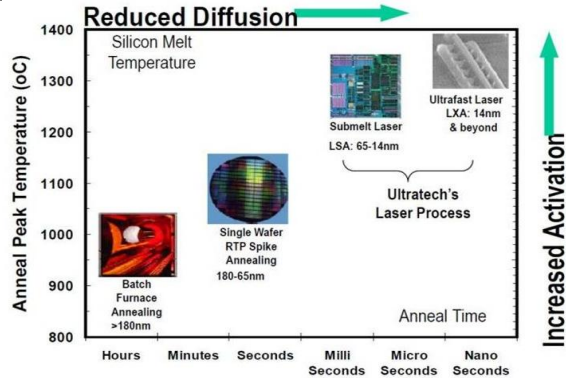
NAND에서의 레이저 어닐링 적용은 DRAM 대비 늦게 본격화되고 있으나, 적층 단수가 200단을 넘어 300단 이상으로 진행되면서 필요성이 점차 높아지고 있다. 3D NAND는 수십~수백 층의 워드라인(WL)이 수직으로 적층된 구조이며, 이 사이를 수직으로 관통하는 채널홀(Channel Hole)에 폴리실리콘(Poly-Si) 채널이 형성된다. 폴리실리콘은 결정 방향이 서로 다른 결정립이 맞닿는 경계면인 결정립계(Grain Boundary)가 많아 전하 이동도가 낮고 트랩 밀도가 높은데, 레이저 어닐링을 통해 결정립 성장을 유도하면 채널 이동도와 셀 전기적 특성 개선이 가능하다. 또한 수백 층 적층 구조에서는 층간 절연막 증착, 워드라인 금속 충전, 이온주입 등 각 공정 이후 어닐링이 필요할 때마다 이미 완성된 하위 레이어에 열 손상을 주지 않아야 하는데, 전통적 방식으로 300도 이상의 온도를 가할 경우 하위 층의 산화막이나 금속 배선 특성이 변할 수 있다. 레이저 어닐링은 가열 대상 레이어만 선택적으로 처리할 수 있어 해당 문제를 해결할 수 있다는 장점이 있다. 다만 NAND는 구조적 복잡성으로 인해 레이저 침투 깊이와 패턴 효과 제어가 DRAM 대비 까다로워, 적용 범위 확대 속도는 상대적으로 더디게 진행될 것으로 예상된다.

메모리에서 EUV 공정이 확대될수록 레이저 어닐링의 수요도 동반 성장할 전망

메모리에서 EUV 공정이 확대될수록 레이저 어닐링의 수요도 동반 성장할 것으로 보인다. DRAM 기준으로 1znm 이하 노드에서 EUV가 본격 도입되면서 패턴 피치가 수십 nm 이하로 줄어들고, 이에 따라 S/D junction 깊이도 수 nm 이하로 극도로 얇아져야 한다. 하지만 EUV 공정이 도입되는 노드에서는 이미 복수의 고온 공정이 누적되어 있어 남아 있는 열 예산(thermal budget)이 극히 제한적이다. 이 상태에서 RTA처럼 웨이퍼 전체를 1,000°C 가까이 가열하면 이미 형성된 junction이 무너지고, EUV로 형성한 정밀한 패턴이 도펀트 확산에 의해 흐릿해진다. 결국 EUV 도입은 패턴 정밀도를 높이는 동시에, 그 정밀도를 유지하기 위한 저thermal budget 열처리 수요를 확대시킨다. 레이저 어닐링은 현재 기술 중 이 요구를 충족할 수 있다. EUV 도입 노드에서 레이저 어닐링이 필수 공정으로 요구되기 때문에 EUV 투자 사이클과 수요가 동조된다. 메모리 업체가 EUV 장비를 발주할 때 해당 노드 공정 셋업 과정에서 레이저 어닐링 장비도 함께 도입되는 투자 타이밍이 연동되며 미세화가 계속 진행될수록 EUV 장비 대수에 비례하여 어닐링 장비 수요가 성장할 것으로 전망된다.

종합하면 DRAM에서는 라인당 EUV 장비 대수 증가와 고객사의 DRAM 투자 확대에 따라 어닐링 장비 수요 확대가 기대되며, NAND는 400단 이상 구간에서 채용이 본격화될 것으로 판단된다. 또한 현재 동사는 미국 고객사로의 공급이 가시화되고 있다. 미국 고객사로의 공급 확대는 국내 단일 고객사 의존 구조에서 벗어나는 고객 다변화의 시작이라는 의미를 가지며, 향후 꾸준한 해외 고객사 확보 가능성도 존재하는 것으로 판단된다.

반도체 어닐링 기술 세대별 진화



자료: Ultratech, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 그루빙 장비 고객사 확대 전망

커팅 장비는 비메모리 고객사 수요 증가와 국내 메모리 고객사향 그루빙 장비 공급 확대로 성장 중

동사 커팅 장비의 매출 고성장이 지속되고 있다. 2023년 100억 원 수준이었던 커팅 장비 매출액은 2025년 500억 원대 중반까지 확대된 것으로 파악되며, 이는 비메모리 고객사 수요 증가와 국내 메모리 고객사향 그루빙(Grooving) 장비 공급 확대에 기인한다.

그루빙 장비는 웨이퍼 표면에 레이저로 얇은 홈(Groove)을 먼저 형성한 후 다이아몬드 블레이드로 풀 커팅하는 방식이다. 블레이드 단독 절단 대비 칩핑(Chipping)이나 미세 균열(Crack) 발생이 적고, Low-k 막처럼 기계적 강도가 낮은 구조에서도 박리(Delamination) 없이 절단이 가능해 HBM이나 비메모리 공정에 특히 적합하다. 그루빙 장비는 현재 HBM 공정에서 핵심적으로 사용되고 있다. HBM은 다수의 DRAM 다이를 TSV로 적층하는 구조로, 적층 단수가 증가할수록 개별 다이를 얇게 가공해야 한다. 그런데 스틸스(Stealth) 다이싱은 레이저를 웨이퍼 내부에 집속해 미세한 균열 구조를 형성한 뒤, 외부 힘으로 그 구조를 따라 분리하는 방식이어서 일정 수준 이상의 웨이퍼 두께가 필요하다. HBM 웨이퍼가 박형화되면서 균열 구조를 형성할 물리적 여유가 줄어들었고, 고객사의 HBM 공정에서는 스틸스 다이싱 적용이 어려워지면서 표면에서 직접 홈을 가공하는 그루빙 방식이 채택되고 있는 것으로 판단된다.

동사는 Ultra Short Pulse 레이저 기술을 기반으로 펄스 지속시간 10⁻¹⁵초 수준의 장비를 일본 경쟁사보다 앞서 국내 고객사에 공급을 시작하였다. 펄스 지속시간이 짧을수록 열영향부(Heat Affected Zone)가 최소화되어 미세 회로나 금속 배선이 밀집된 영역에서도 손상 없는 가공이 가능하나, 광원 제작 난도와 비용이 높아 상용화에 성공한 업체는 제한적이다. 커팅 장비 시장은 펄스 지속시간 10⁻¹²초 수준의 피코초 장비 수요가 약 80%, 10⁻¹⁵초 수준의 Ultra Short Pulse 장비 수요가 약 20%를 차지하는 구조인데, 동사는 전자에서 20% 미만, 후자에서는 50% 이상의 점유율을 확보하고 있는 것으로 파악된다. 동사는 상대적으로 새롭게 성장하는 시장에서 기술 우위를 바탕으로 높은 점유율을 가

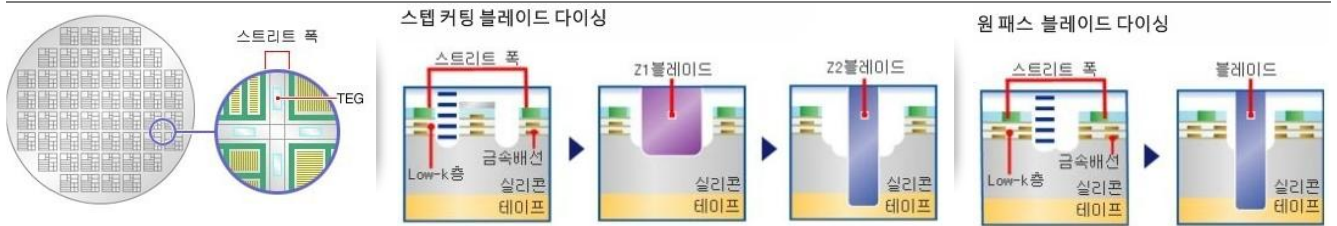
저가고 있다.

또 다른 메모리 업체 역시 그루빙 장비로의 전환을 검토 중인 것으로 파악된다. 이 업체는 MUF(Mass Underfill) 공정 채택으로 상대적으로 스텔스 다이싱 적용이 가능했으나, HBM 웨이퍼 박형화로 적용에 한계가 발생함에 따라 그루빙 방식으로의 전환을 검토하고 있는 것으로 파악된다. 복수의 메모리 업체를 대상으로 장비 평가가 진행되고 있으나 양사의 신규 Fab 가동 시점이 내년으로 예상되는 만큼 실질적인 매출 반영은 이후로 늦춰질 가능성이 있다.

비메모리 영역에서도 그루빙 장비에 대해 대만 Foundry의 관심이 높아지고 있는 것으로 파악된다. 대만 업체는 기존에 일본 장비를 사용해왔으나 엔드 고객사의 요청에 따라 동사 장비 도입이 이루어진 것으로 파악되며, 이는 향후 비메모리 파운드리향 공급 확대 가능성을 기대할 수 있는 부분이다.

따라서 그루빙 장비는 국내 고객사 HBM향 공급을 기반으로 신규 메모리 고객사 확대와 대만 Foundry를 포함한 비메모리 고객사 확대가 동시에 진행되고 있어, 향후 커팅 장비 매출 성장의 핵심 축으로 자리잡을 것으로 판단된다.

그루빙(Grooving) 다이싱 프로세스



자료: Disco, 한국IR협의회 기업리서치센터

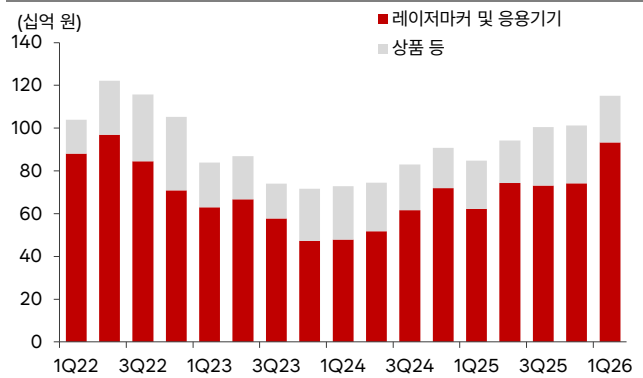
실적 추이 및 전망

1 반도체 매출 비중 확대된 2025년

2025년 매출액 3,809억 원(+18.7% YoY), 영업이익 808억 원(+158.8% YoY) 기록

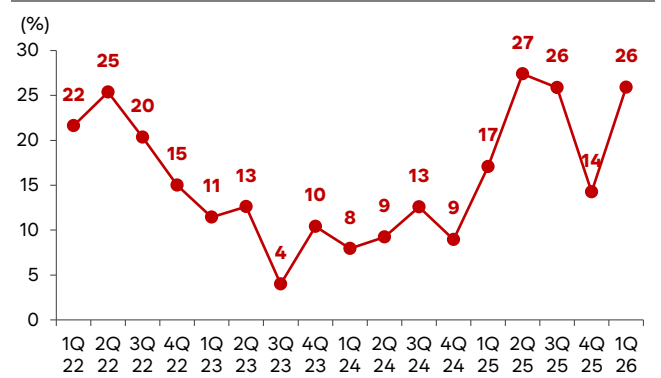
2025년 동사는 매출액 3,809억 원(+18.7% YoY), 영업이익 808억 원(+158.8% YoY)을 기록하였다. 매출 성장률을 크게 상회하는 영업이익 성장은 반도체 매출 비중 확대에 기인한다. 2024년 60% 수준이었던 반도체 매출 비중은 2025년 80%까지 확대되었으며, 이에 따라 영업이익률은 21.2%로 전년 대비 11.5%p 개선되었다. 제품별로는 레이저 마커 수요가 급격히 증가하였다. 특정 고객사의 GPU 관련 마킹 수요가 확대된 가운데, 방열판과 EMI 실드 마킹 장비가 추가되며 수요를 견인하였으며, 해당 수요는 현재까지도 이어지고 있는 것으로 파악된다. 어닐링 장비는 2024년 까지 주요 고객사의 투자 공백으로 수요가 제한적이었으나, 메모리 투자가 재개되며 매출이 증가세를 보였다. 커팅 장비는 비메모리 수요 증가와 메모리 고객사향 공급 확대가 이루어졌다. 디본더 역시 대만 고객사향 수요 증가와 신규 OSAT 고객사 추가로 매출 비중이 8%까지 확대되었다. 반면 PCB 부문에서는 MLB(다층기판) 수요 자체는 양호하였으나, 동사 레이저 드릴러 장비 수요로의 연결은 제한적이었다. 분기별로는 2, 3분기 이익률이 양호하였던 반면 1분기와 4분기에는 상대적으로 이익률이 낮은 디스플레이 및 2차전지 매출이 집중되며 이익률이 저하되었다. 특히 4분기에는 출하 예정이었던 어닐링 장비 일부가 26년 1분기로 이연되며 매출과 이익이 동반 둔화되었고, 연말 보너스 지급에 따른 비용 증가도 일부 영향을 미친 것으로 판단된다.

이오테크닉스 부문별 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

이오테크닉스 분기별 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 공정 및 고객사 확대 지속될 2026년

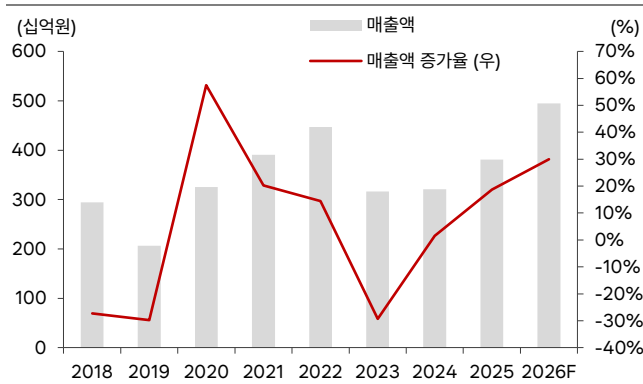
2026년 매출액 4,948억원(+29.9% YoY), 영업이익 1,309억원(+62.1% YoY) 전망

1Q26 동사는 매출액 1,151억 원(+35.7% YoY, +13.6% QoQ), 영업이익 298억 원(+105.8% YoY, +106.3% QoQ)을 기록하였다. 2025년 80% 수준까지 확대된 반도체 매출 비중이 1분기에도 그대로 유지되며, 영업이익률은 25.9%로 전년 동기 17.1% 대비 +8.8%p 추가 개선되었다. 특히 1Q26에는 4Q25에서의 이연 물량 반영이 매출 증가에 기여하였다.

2026년 동사의 연간 실적은 매출액 4,948억원(+29.9% YoY), 영업이익 1,309억원(+62.1% YoY)을 전망한다. 레이저 마커는 방열판-EMI 실드 마킹 등 신규 장비 수요가 견인할 것으로 판단된다. 레이저 어닐링은 작년과 유사한 매출액

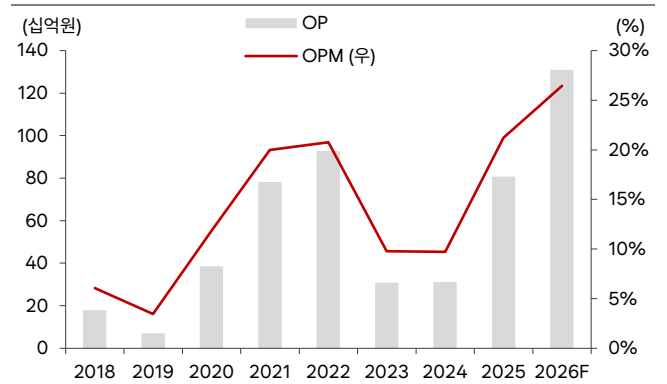
수준을 예상한다. 여전히 고객사의 Fab 공간이 제약되며 동사 장비 기준으로는 공급량이 유사할 것으로 판단되기 때문이다. 2027년에는 신규 고객 확보, 고객사 NAND 투자 등으로 매출액이 2배 이상 크게 확대될 것으로 전망한다. 커팅 장비는 HBM향 Ultra Short Pulse 장비 공급을 중심으로 성장이 지속될 것으로 전망한다. 메모리 신규 고객 및 비메모리로 확대는 신규 Fab이 열리는 2027년 본격화될 것으로 예상한다. 디본더는 CoWoS-L향 수요 증가세 둔화로 투자 규모는 작년과 유사하나, OSAT향 비중 확대로 매출은 증가할 것으로 전망한다. 내년 CoPoS 장비 도입이 시작되면 패널 사이즈 확대에 따라 장비 단가가 크게 상승할 가능성이 있다. PCB는 FC-BGA 및 실리콘 커패시터향 수요 강세로 신규 장비 매출이 확대될 것으로 전망한다. 수익성 측면에서는 매출액 확대와 상대적으로 수익성이 높은 반도체 장비 매출 비중 증가로 전년대비 +5.3%p 개선된 OPM 26.5%를 전망한다.

이오테크닉스 매출액 및 매출액 증가율 추이



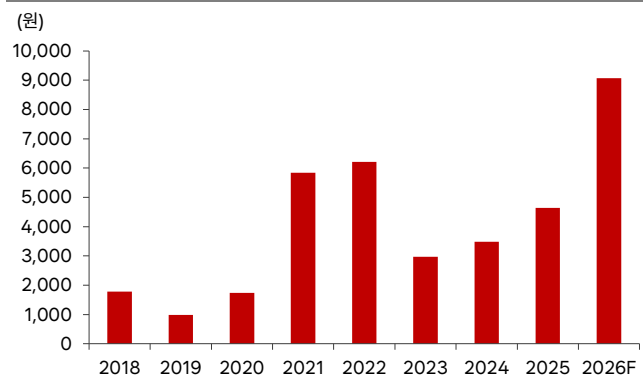
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 영업이익 및 영업이익률 추이



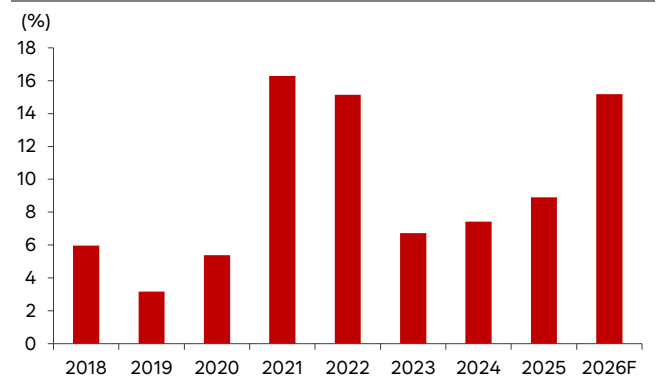
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 부문별 실적

(단위: 십억원)

| | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 매출액 | 83.9 | 86.9 | 74.0 | 71.6 | 72.8 | 74.4 | 83.0 | 90.7 | 84.8 | 94.3 | 100.5 | 101.3 | 115.1 | 316 | 321 | 381 | 495 |
| 레이저 마커 및 응용기기 | 62.9 | 66.6 | 57.7 | 47.2 | 47.8 | 51.8 | 61.6 | 71.9 | 62.2 | 74.3 | 73.2 | 74.2 | 93.3 | 234 | 233 | 284 | 389 |
| 상품 등 | 21.0 | 20.2 | 16.3 | 24.5 | 25.0 | 22.6 | 21.4 | 18.8 | 22.6 | 20.0 | 27.3 | 27.1 | 21.8 | 82 | 88 | 97 | 106 |
| 영업이익 | 9.6 | 10.9 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 6.6 | 10.4 | 8.6 | 14.5 | 25.8 | 26.0 | 14.4 | 29.8 | 31 | 31 | 81 | 131 |
| 지배주주순이익 | 13.6 | 12.5 | 8.0 | 2.5 | 10.6 | 10.9 | 4.9 | 16.5 | 14.4 | 2.5 | 23.2 | 17.1 | 31.2 | 37 | 43 | 57 | 112 |
| Margin(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 영업이익률 | 11.4 | 12.6 | 4.0 | 10.4 | 7.6 | 8.8 | 12.6 | 9.5 | 17.1 | 27.4 | 25.9 | 14.3 | 25.9 | 10 | 10 | 21 | 26 |
| 지배주주순이익률 | 16.2 | 14.4 | 10.8 | 3.5 | 14.6 | 14.6 | 5.9 | 18.2 | 17.0 | 2.6 | 23.1 | 16.9 | 27.1 | 12 | 13 | 15 | 23 |
| YoYGrowth(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매출액 | -19.3 | -28.9 | -36.1 | -32.0 | -13.2 | -14.3 | 12.2 | 26.6 | 16.5 | 26.7 | 21.1 | 11.6 | 35.7 | -29 | 1 | 19 | 30 |
| 레이저 마커 및 응용기기 | -28.6 | -31.2 | -31.7 | -33.4 | -24.0 | -22.3 | 6.7 | 52.3 | 30.1 | 43.4 | 18.8 | 3.2 | 50.0 | -31 | -1 | 22 | 37 |
| 상품 등 | 32.4 | -19.9 | -48.0 | -28.8 | 19.4 | 11.9 | 31.5 | -23.2 | -9.6 | -11.7 | 27.8 | 44.2 | -3.7 | -23 | 7 | 10 | 9 |
| 영업이익 | -57.3 | -64.7 | -87.5 | -52.8 | -42.2 | -39.9 | 253.3 | 16.0 | 150.6 | 276.1 | 149.2 | 77.8 | 105.8 | -67 | 1 | 159 | 62 |
| 지배주주순이익 | -32.5 | -49.3 | -74.1 | 192.7 | -219 | -13.0 | -39.2 | 551.8 | 35.7 | -77.0 | 376.5 | 4.0 | 116.6 | -52 | 17 | 34 | 95 |
| QoQGrowth(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매출액 | -20.3 | 3.5 | -14.8 | -3.1 | 1.7 | 2.2 | 11.5 | 9.3 | -6.5 | 11.1 | 6.6 | 0.8 | 13.6 | | | | |
| 레이저 마커 및 응용기기 | -11.3 | 5.9 | -13.4 | -18.2 | 1.2 | 8.3 | 18.9 | 16.8 | -13.5 | 19.4 | -1.5 | 1.4 | 25.8 | | | | |
| 상품 등 | -39.0 | -3.6 | -19.6 | 50.5 | 2.3 | -9.6 | -5.5 | -12.1 | 20.4 | -11.7 | 36.8 | -0.8 | -19.6 | | | | |
| 영업이익 | -39.3 | 14.1 | -73.0 | 152.5 | -25.6 | 18.5 | 58.6 | -17.1 | 78.3 | 78.3 | 0.7 | -44.5 | 106.3 | | | | |
| 지배주주순이익 | 1,473 | -8.0 | -36.1 | -68.4 | 319.9 | 2.4 | -55.3 | 239 | -12.6 | -82.7 | 828.2 | -26.0 | 82.1 | | | | |

자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

Valuation

2026F PER 55.0x

**2027년 고객사의 신규 Fab
오픈과 어닐링과 커팅 장비 고객사
다변화, PCB 장비 확대 등으로
인한 실적 확대가 예상되는 점이
Valuation 프리미엄을 합당화**

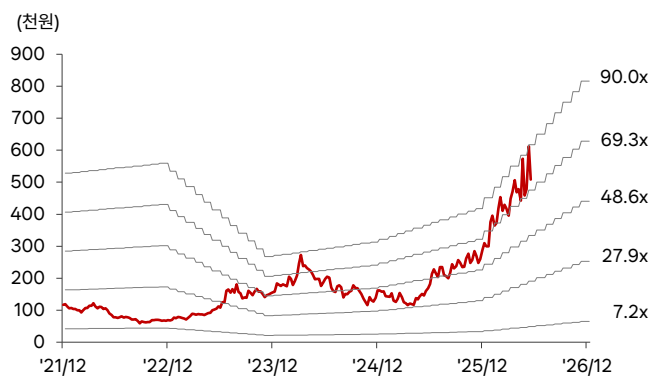
동사의 현주가는 2026F PER 55.0x로 Historical PER Band(7.2x~90.0x) 중단에 위치해 있다. 동사의 Peer 업체로는 레이저 장비 업체를 선정하였다. 이 중 동사의 어닐링 경쟁사인 다이이티는 컨센서스가 부재하여 비교가 어렵다. AP시스템(6.4x)은 매출의 약 90%가 디스플레이 장비 중심인 점이 낮은 Valuation의 이유라 판단한다. 필옵틱스(498.2x)는 높은 PER을 보이고 있는데 이는 실적 개선 속도 대비 유리기판에 대한 기대감이 주가에 크게 반영되었기 때문이다. 필옵틱스의 2026년 Valuation을 제외한다면, 이오테크닉스는 역사적으로 Peer 업체들 대비 높은 Valuation을 부여 받아 왔다. 이는 레이저 기술을 중심으로 어닐링, 커팅, 디본딩 장비 등 지속적으로 장비군과 적용 공정을 확대해 왔으며, 특히 전공정 장비인 어닐링 장비를 고객사에 독점적으로 공급하고 있다는 점에 기인한다. 더욱이 2027년 고객사의 신규 Fab 오픈과 어닐링과 커팅 장비 고객사 다변화, PCB 장비 확대 등으로 인한 실적 확대가 예상되는 점이 Valuation 프리미엄을 합당화 시키고 있다.

동종 업종 밸류에이션

| 기업명 | 종가 (원) | 시가총액 (십억원) | 매출액(십억원) | | | PER(배) | | | PBR(배) | | |
|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026F | 2024 | 2025 | 2026F | 2024 | 2025 | 2026F |
| 코스피 | 9,052 | 7,186,860 | 3,712,325 | 3,916,545 | 3,934,675 | 11.3 | 15.4 | 9.7 | 0.8 | 1.3 | 2.3 |
| 코스닥 | 967 | 542,786 | 332,661 | 361,183 | 114,372 | 211.2 | 112.3 | 30.1 | 1.5 | 2.1 | 3.5 |
| 이오테크닉스 | 498,500 | 6,141 | 321 | 381 | 495 | 40.0 | 58.6 | 55.0 | 2.9 | 4.9 | 7.8 |
| AP시스템 | 23,400 | 352 | 517 | 460 | 625 | 4.7 | 12.4 | 6.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 다이이티 | 22,550 | 426 | 117 | 108 | - | 8.2 | 9.1 | - | 1.1 | 1.1 | - |
| 필옵틱스 | 42,350 | 993 | 411 | 103 | 257 | 19.5 | - | 498.2 | 3.6 | 8.8 | 6.6 |
| 동종업종 평균 | | | | | | 10.8 | 10.7 | 252.3 | 1.8 | 3.6 | 3.7 |

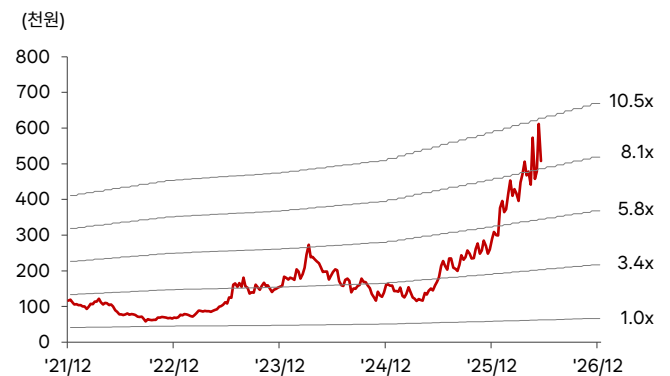
주: 2026년 06월 19일 종가 기준. 다이이티는 26F 컨센서스 없음. 동종그룹 26F는 시장 컨센서스 사용
자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 PER Band



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

이오테크닉스 PBR Band



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터


리스크 요인
㉑ 높은 단일 고객사 의존도와 성장 동력 집중 리스크

삼성전자 매출 비중이 상대적으로 높으나, 신규 고객 다변화가 진행 중으로 신규 Fab 가동 시점에 맞춰 의존도 리스크는 점진적으로 완화될 것으로 기대

동사의 리스크는 상대적으로 높은 삼성전자 매출 비중으로 판단된다. 어닐링 장비는 현재 삼성전자에 독점 공급되는 구조이며, 마커 및 그루빙 장비 역시 삼성전자 비중이 절대적인 수준이다. 과거 2024년 초 삼성전자의 HBM 인증 지연 이슈로 동사의 주가가 큰 폭으로 하락한 사례가 있었던 만큼, 삼성전자의 CAPEX 의사결정과 신규 Fab 투자 일정 지연은 동사 실적에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 요인으로 판단된다. 다만 신규 고객 다변화가 진행 중이며, 신규 Fab 가동 시점에 맞춰 점진적으로 의존도가 완화될 것으로 기대된다.

투자 사이클 측면에서는 부문별 성장 가정이 동일한 시점에 집중되어 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 어닐링, 그루빙, 디분더 등 주요 성장 동력의 가시화 시점이 대부분 신규 Fab 가동 시점에 맞춰져 있어, 여러 성장 동력이 동시에 가동되고 있다는 점은 동사의 강점이나 해당 동력들이 유사한 시점에 맞물려 있는 만큼 일부 지연이 발생할 경우 실적 추정치에 미치는 영향이 동시다발적으로 나타날 가능성도 존재한다.

포괄손익계산서

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액 | 4,472 | 3,163 | 3,209 | 3,809 | 4,948 |
| 증가율(%) | 14.4 | -29.3 | 1.5 | 18.7 | 29.9 |
| 매출원가 | 2,944 | 2,293 | 2,319 | 2,418 | 3,043 |
| 매출원가율(%) | 65.8 | 72.5 | 72.3 | 63.5 | 61.5 |
| 매출총이익 | 1,528 | 870 | 890 | 1,391 | 1,905 |
| 매출이익률(%) | 34.2 | 27.5 | 27.7 | 36.5 | 38.5 |
| 판매관리비 | 600 | 561 | 578 | 583 | 596 |
| 판매비율(%) | 13.4 | 17.7 | 18.0 | 15.3 | 12.0 |
| EBITDA | 1,025 | 388 | 374 | 867 | 1,393 |
| EBITDA 이익률(%) | 22.9 | 12.3 | 11.7 | 22.8 | 28.2 |
| 증가율(%) | 15.2 | -62.1 | -3.6 | 131.8 | 60.7 |
| 영업이익 | 928 | 309 | 312 | 808 | 1,309 |
| 영업이익률(%) | 20.8 | 9.8 | 9.7 | 21.2 | 26.5 |
| 증가율(%) | 18.8 | -66.7 | 0.8 | 158.8 | 62.1 |
| 영업외손익 | 73 | 312 | 333 | 33 | 133 |
| 금융수익 | 261 | 194 | 401 | 244 | 214 |
| 금융비용 | 199 | 115 | 81 | 184 | 52 |
| 기타영업외손익 | 11 | 233 | 12 | -26 | -29 |
| 중속/관계기업관련손익 | 7 | 2 | -1 | -0 | -0 |
| 세전계속사업이익 | 1,008 | 623 | 644 | 840 | 1,441 |
| 증가율(%) | 8.6 | -50.1 | 27.3 | 31.3 | 71.6 |
| 법인세비용 | 235 | 138 | 213 | 264 | 317 |
| 계속사업이익 | 772 | 471 | 467 | 576 | 1,124 |
| 중단사업이익 | 0 | -121 | -4 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 772 | 364 | 427 | 576 | 1,124 |
| 당기순이익률(%) | 17.3 | 11.5 | 13.3 | 15.1 | 22.7 |
| 증가율(%) | 6.8 | -52.9 | 17.2 | 34.9 | 95.3 |
| 지배주주지분 순이익 | 765 | 366 | 428 | 572 | 1,117 |

현금흐름표

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 927 | 316 | 554 | 1,003 | 1,421 |
| 당기순이익 | 772 | 364 | 427 | 576 | 1,124 |
| 유형자산 상각비 | 89 | 71 | 56 | 54 | 79 |
| 무형자산 상각비 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 외환손익 | 80 | 45 | 33 | 132 | 0 |
| 운전자본의감소(증가) | -14 | 33 | 64 | 9 | 190 |
| 기타 | -8 | -204 | -32 | 226 | 23 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -58 | 256 | -376 | -1,156 | -558 |
| 투자자산의 감소(증가) | -42 | 288 | 265 | -96 | -18 |
| 유형자산의 감소 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 유형자산의 증가(CAPEX) | -38 | -50 | -637 | -39 | -250 |
| 기타 | 1 | 15 | -5 | -1,021 | -290 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -211 | -157 | -64 | 317 | -148 |
| 차입금의 증가(감소) | -0 | -34 | 0 | -20 | 0 |
| 사채의증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본의 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금 | -110 | -121 | -54 | -61 | -148 |
| 기타 | -101 | -2 | -10 | 398 | 0 |
| 기타현금흐름 | 6 | -7 | 107 | -23 | -29 |
| 현금의증가(감소) | 664 | 408 | 222 | 141 | 685 |
| 기초현금 | 928 | 1,592 | 2,001 | 2,222 | 2,363 |
| 기말현금 | 1,592 | 2,001 | 2,222 | 2,363 | 3,049 |

재무상태표

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 유동자산 | 4,237 | 4,293 | 4,456 | 5,463 | 6,448 |
| 현금성자산 | 1,592 | 2,001 | 2,222 | 2,363 | 3,049 |
| 단기투자자산 | 108 | 31 | 31 | 994 | 1,292 |
| 매출채권 | 809 | 818 | 989 | 869 | 900 |
| 재고자산 | 1,615 | 1,350 | 1,125 | 1,153 | 1,100 |
| 기타유동자산 | 113 | 94 | 89 | 83 | 108 |
| 비유동자산 | 1,921 | 1,823 | 2,074 | 2,315 | 2,498 |
| 유형자산 | 1,223 | 1,073 | 1,341 | 1,503 | 1,674 |
| 무형자산 | 46 | 51 | 48 | 40 | 35 |
| 투자자산 | 516 | 472 | 225 | 338 | 356 |
| 기타비유동자산 | 136 | 227 | 460 | 434 | 433 |
| 자산총계 | 6,159 | 6,117 | 6,530 | 7,778 | 8,946 |
| 유동부채 | 762 | 470 | 481 | 878 | 1,065 |
| 단기차입금 | 118 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| 매입채무 | 225 | 157 | 150 | 235 | 250 |
| 기타유동부채 | 419 | 223 | 241 | 573 | 745 |
| 비유동부채 | 6 | 22 | 19 | 20 | 26 |
| 사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기차입금 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타비유동부채 | 1 | 22 | 19 | 20 | 26 |
| 부채총계 | 768 | 492 | 500 | 899 | 1,091 |
| 지배주주지분 | 5,323 | 5,559 | 5,973 | 6,879 | 7,849 |
| 자본금 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 자본잉여금 | 760 | 760 | 758 | 669 | 669 |
| 자본조정 등 | -156 | -156 | -156 | 0 | 0 |
| 기타포괄이익누계액 | 39 | 29 | 71 | 99 | 99 |
| 이익잉여금 | 4,618 | 4,864 | 5,238 | 6,049 | 7,019 |
| 자본총계 | 5,391 | 5,625 | 6,030 | 6,879 | 7,855 |

주요투자지표

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P/E(배) | 10.7 | 51.4 | 40.0 | 58.6 | 55.0 |
| P/B(배) | 1.5 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 7.8 |
| P/S(배) | 1.8 | 6.0 | 5.3 | 8.8 | 12.4 |
| EV/EBITDA(배) | 6.5 | 43.7 | 40.2 | 34.9 | 41.0 |
| 배당수익률(%) | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| EPS(원) | 6,212 | 2,973 | 3,478 | 4,644 | 9,071 |
| BPS(원) | 43,208 | 45,119 | 48,481 | 55,838 | 63,709 |
| SPS(원) | 36,297 | 25,678 | 26,052 | 30,918 | 40,163 |
| DPS(원) | 1,000 | 450 | 500 | 1,200 | 1,200 |
| 수익성(%) | | | | | |
| ROE | 15.1 | 6.7 | 7.4 | 8.9 | 15.2 |
| ROA | 13.1 | 5.9 | 6.7 | 8.0 | 13.4 |
| ROIC | 21.5 | 6.5 | 10.6 | 15.4 | 35.7 |
| 안정성(%) | | | | | |
| 유동비율 | 556.2 | 913.1 | 926.4 | 622.0 | 605.7 |
| 부채비율 | 14.2 | 8.8 | 8.3 | 13.1 | 13.9 |
| 순차입금비율 | -29.2 | -34.5 | -35.9 | -47.8 | -54.4 |
| 이자보상배율 | 281.5 | 89.0 | 113.4 | 399.7 | 737.9 |
| 활동성(%) | | | | | |
| 총자산회전율 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 매출채권회전율 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5.6 |
| 재고자산회전율 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 4.4 |

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

| 종목명 | 투자주의종목 | 투자경고종목 | 투자위험종목 |
|--------|--------|--------|--------|
| 이오테크닉스 | ○ | ○ | X |

2026년 4월 30일 주가급등에 따른 투자경고, 2026년 4월 29일 및 2026년 5월 18일 투자경고 지정예고/해제에 따른 투자주의, 2026년 5월 29일 기준 소수계좌 매수관여 과다 종목으로 지정된 바 있음

발간 History

| 발간일 | 제목 |
|------------|----------------------------------|
| 2026.06.23 | 이오테크닉스-공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요 |
| 2025.06.11 | 이오테크닉스-반도체향 매출 비중 증가는 현재형 |

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출간한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/irsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRT'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '소중한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '소중한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.